

少量カスタムIC × Global Design Team

日本製造業の「次の一手」

独自IC設計 × グローバル設計人材

セットメーカー主導の少量カスタム半導体開発と、AI時代に現実解となった
費用・期間の壁を越える設計リソース戦略を、3部構成で提示します。

**南川 明 氏**

Omdia シニアコンサルティングディレクター
RISE-A エバンジェリスト

**大幸 秀成 氏**

BHオフィス 代表／半導体エバンジェリスト
株式会社YSタレント 半導体事業顧問

**前田 智之 氏**

株式会社YSタレント 代表取締役

2026 **9/25** **金** セミナー 15:00 ~ 17:30
【懇親会 17:30 ~ 18:30】

| 開催 | ハイブリッド開催 現地参加＋オンライン配信

| 会場 | RISE GATE NIHONBASHI 東京都中央区日本橋室町1-7-1 スルガビル7階

| 定員 | 会場80名（先着）／ オンライン：定員無し

大量生産では勝てない。日本の勝ち筋は「少量多品種・長寿命」にある。

日本が強い産業機器・インフラ・ロボット・自動車は、汎用半導体の組合せゆえに電力・面積・コストの無駄とEOL（生産終了）リスクを抱えています。いま、AI・設計自動化により「少量カスタムIC」が採算に乗る時代が始まりました。

こんな課題をお持ちの企業様へ

01 汎用品の組合せで電力・サイズ・コストに無駄
冗長設計が消費電力・重量・部品点数を押し上げ、競争力を奪っている。

02 部品のEOL・サプライチェーンリスク
部品点数が多く供給網リスクが常に伴う。10～30年使う機器は汎用品の終息が保守・設計を直撃。

03 独自ICの採算・進め方がわからない
少量生産でコストを回収できるのか、設計会社との付き合い方が見えない。

04 半導体設計人材を確保できない
国内不足が深刻で、海外リソースの活用も具体的に検討する必要がある。

プログラム

15:00-17:30 / 懇親会 17:30-18:30

PART 1

15:00-15:55

市場データ

汎用品 vs カスタム半導体の
市場構造を読み解く

南川 明 氏

Omdia シニアコンサルティング
ディレクター

PART 2

16:00-16:55

勝ち筋構想

少量カスタムICは、なぜ
日本の製造業の勝ち筋なのか

大幸 秀成 氏

BHオフィス 代表／半導体エバンジェリスト
株式会社YSタレント 半導体事業顧問

PART 3

17:00-17:15

人材活用モデル

ベトナム半導体設計人材の
育成・還流モデル

前田 智之

株式会社YSタレント 代表取締役

お申込みは Peatix にて受付（事前登録制）

セミナー 特別会員無料／一般1,000円・懇親会1,000円 ※詳細は裏面

登壇者プロフィール

**南川 明 氏**

Omdia シニアコンサルティングディレクター
／RISE-A エバンジェリスト

40年近く半導体市場調査の第一線に立つ、日本を代表する半導体アナリスト。JEITA「世界電子機器・半導体の中長期展望」の中心アナリストを20年務め、特許庁審査委員、NEDO研究評価委員等を歴任。テレビ・経済メディアでの市場解説も多数。

**大幸 秀成 氏**

BHオフィス 代表／半導体エバンジェリスト
／株式会社YSタレント 半導体事業顧問

1982年東芝入社。約40年にわたり半導体事業に従事し、小信号半導体応用技術部長、技術マーケティング統括部 技監として産業機器・IoT・ロボティクス市場の技術マーケティングを統括。監修書に『ビジネス教養として知っておくべき半導体』。

**前田 智之**

株式会社YSタレント 代表取締役

慶應義塾大学卒。JTB、コムスンを経て2009年チップワンストップで半導体分野の海外事業を推進。2015年フローラ・アミ設立（現YSタレント）、2019年代表取締役就任。ベトナムではダナンでの半導体人材育成に参画。ハノイ工科大学・水利大学・フェニカ大学など現地一流大学との提携を先駆けて進めている。

なぜ「セットメーカーの独自IC」なのか — 3つの裏付け

REASON 01

世界のセットメーカーが独自チップ化 — 供給リスクも一因

Google・Apple・Teslaなど世界の大手は独自チップで性能・電力・コストを差別化。部品点数が圧倒的に多い半導体は供給網リスクが常に伴い、内製・集約が加速。

REASON 02

日本の製造基盤は強い。足りないのは設計人材

デバイス世界シェアは約1割まで低下した一方、製造装置は約3割・材料は約5割と製造基盤は世界トップ級。

REASON 03

ベトナムが国策で5万人育成 — 設計教育が急拡大

2030年までに半導体人材5万人を国策で育成。Synopsys設計ツールによるベトナム人設計者の採用・教育が国内で進行中（2027年3月入社予定）。半導体Mapが動く前兆です。

開催概要

- 日時** 2026年9月25日（金）15:00～17:30（開場 14:30／懇親会 17:30～18:30 ※会場参加者のみ）
- 会場** RISE GATE NIHONBASHI 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-7-1 スルガビル7階
東京メトロ三越前駅 A1出口から徒歩1分／JR東京駅から徒歩12分 + オンライン配信（Zoomウェビナー）
- 定員** 会場80名（先着・事前登録制）／オンラインは定員なし
- 対象者** 製造業・セットメーカーの経営者／事業・技術責任者、開発設計・調達・人事部門のご担当者

参加費・お申込み方法

セミナー参加費

RISE-A特別会員
一般

無料
1,000円

懇親会参加費

ご参加者全員（お一人様）

1,000円

会場・オンライン共通／懇親会は会場参加者のみ。
RISE-A会員様には優待コードを発行します。チケット購入前に
下記アドレスへご連絡ください support@ystalent.co.jp

お申込み方法

Peatix よりお申込みください（事前登録制）

- ① Peatixのイベントページでチケットを選択
- ② RISE-A特別会員の方は優待コードを入力（0円）
- ③ 開催前日までに視聴URL・当日案内をお送りします



Peatixイベントページ

<https://peatix.com/event/5136601>

※スマホのカメラでQRコードを読み取れます

お問い合わせ 株式会社YSタレント セミナー事務局 / support@ystalent.co.jp / 045-319-6844（平日 9:30～18:00）